



VIA Technologies, Inc.

531 Zhongzheng Road, 1F | Xindian Dist, New Taipei City 231 | Taiwan
Tel: +886-2-2218-1838 | Fax: +886-2-2218-8924 | www.viatech.com

VIA、Qualcomm® Snapdragon™ 820E エンベデッド・プラットフォーム採用の VIA SOM-9X20 エッジ AI 開発キットの Chip One Stop における取り扱いを開始

2018年8月23日 台湾・新北市 - VIA Technologies, Inc.は、本日、Qualcomm Incorporated の子会社である Qualcomm Technologies, Inc の Qualcomm® Snapdragon™ 820E エンベデッド・プラットフォームを採用することでインテリジェントなエッジ AI システムおよびデバイスの設計、テストおよび展開を簡素化する VIA SOM-9X20 エッジ AI 開発キットについて、株式会社チップワンストップ(本社:神奈川県横浜市)の運営する電子部品および半導体の通販サイト Chip One Stop (<https://www.chip1stop.com/>) で取り扱いを開始すると発表しました。これにより、これまでの VIA オンラインショップを通じての販売に比べて、よりお手軽に、かつ迅速に VIA SOM-9X20 エッジ AI 開発キットをお手もとにお届けできるようになります。



本キットは、VIA SOM-9X20 SOM モジュールと SOMDB2 キャリアボード、インテリジェントなリアルタイムのビデオキャプチャ、プロセッシングおよびエッジ解析に最適化された 13MP カメラモジュールを組み合わせています。エッジ AI アプリケーションの開発は Snapdragon Neural Processing Engine (NPE) のサポートと、AI アプリケーションを駆動する Qualcomm® Hexagon™ DSP、Qualcomm® Adreno™ 530 GPU、または Qualcomm® Kryo™ CPU のフルアクセラレーションをに対応した Android 8.0 BSP または Yocto 2.0.3 に基づく Linux BSP で可能になります。

VIA、Qualcomm® Snapdragon™ 820E エンベデッドプラットフォーム採用の VIA SOM-9X20 エッジ AI 開発キットの Chip One One Stop における取り扱いを開始

2/3

今回、Chip One Stop システムで取り扱いを開始する VIA SOM-9X20 エッジ AI 開発キットは以下のとおり。

- VIA SOM-9X20 スターターキット: 96,200 円(税別)
SOM-9X20 モジュール、SOMDB2 キャリアボード
- VIA SOM-9X20 スターターキット(カメラ・ディスプレイ付き): 98,000 円(税別)
VIA SOM-9X20 SOM モジュールと SOMDB2 キャリアボードおよび 13MP CMOS カメラモジュール(COB1/3.06" 4224 × 3136 ピクセル)

VIA SOM-9X20

VIA SOM-9X20 は、Qualcomm の Snapdragon 820E エンベデッドプラットフォームを搭載した高度に統合されたシステム・オン・モジュール(SOM)です。本モジュールは、わずか 8.2 × 4.5cm のサイズで、64GB eMMC フラッシュメモリと 4GB LPDDR4 SDRAM を搭載し、MXM 3.0 314 ピンコネクタを介して USB 2.0、HDMI 2.0、SDIO PCIe、MIPI CSI、MIPI DSI、UART 用多機能ピン、I2C、SPI、GPIO などの豊富な I/O とディスプレイ拡張拡張オプションを提供します。その主な特徴は以下のとおりです。

- Qualcomm® Snapdragon™ 820 エンベデッドプラットフォーム
- 4K @ 60fps、8 × 1080p @ 30fps をサポートする Qualcomm® Adreno™ 430 GPU
- 内蔵 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth 4.1 および GPS の豊富な無線接続性
- MXM 3.0 314 ピンコネクタを備えたコンパクトフォームファクタモジュール
- 5 年間の長期サポート

また、VIA は、システムの商用化を加速し、開発コストを最小限に抑えるハードウェアとソフトウェアのカスタマイズサービスを提供するほか、フルターンキー開発サービスも利用いただけます。

なお、VIA SOM-9X20 の詳細については、次の URL を参照してください。

<https://www.viatech.com/ja/boards-ja/modules/som-9x20/>

このリリースに関する画像については、<https://www.viagallery.com/som-9x20/> をご覧ください。

【Chip One Stop における VIA SOM-9X20 開発キット情報ページ】

<http://sp.chip1stop.com/viasom9x20som/>

VIA Technologies, Inc.について

VIA Technologies, Inc.は、AI、IoT、コンピュータビジョン、自動運転車両、ヘルスケア、スマートシティアプリケーション向けの高度に統合された組み込みプラットフォームおよびシステムソリューションの開発における世界的リーダーです。本社を台湾・台北におき、VIA の国際的なネットワークはアメリカ、ヨーロッパ、そしてアジアのハイテクセンターを結び、顧客層は世界中の最先端のハイテク、通信、家電にまでわたっています。詳しくはこちらをご覗ください。

<http://www.viatech.com/>

VIA、Qualcomm® Snapdragon™ 820E エンベデッドプラットフォーム採用の
VIA SOM-9X20 エッジ AI 開発キットの Chip One One Stop における取り扱いを開始

3/3

お客様からのお問い合わせ先

VIA Technologies Japan 株式会社

メールアドレス: mktjp@viatech.co.jp

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ

Richard Brown (VIA Technologies, Inc. 国際マーケティング担当 VP)

メールアドレス : RIBrown@via.com.tw

HaNaRe PR Group (VIA Technologies, Inc. 日本広報代理)

メールアドレス : press@hanare-pr.jp

記者ならびに編集の方々へお願い: VIA はすべて大文字で表記してください。

Qualcomm, Snapdragon, Kryo, Adreno、およびHexagon は、米国およびその他の国における *Qualcomm Incorporated* の商標です。 *Qualcomm Spectra* は、*Qualcomm Incorporated* の商標です。

Qualcomm Snapdragon, Qualcomm Kryo, Qualcomm Adreno, Qualcomm Hexagon、およびQualcomm Spectra は、*Qualcomm Technologies, Inc.* の製品です。

ここに記載されている実際の企業および製品名は、それぞれの所有者の商標です。